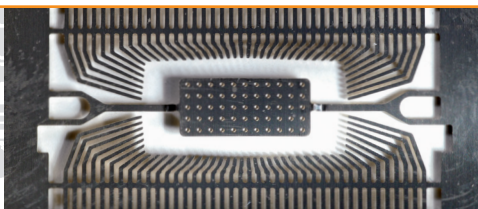


从上往下测量

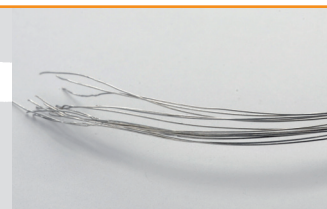
FISCHERSCOPE X-RAY XDV- $\mu$ 测量系统拥有先进的多毛细孔X射线聚焦装置，既能有效地缩小测量点的面积，又能大幅加强射线的强度。仪器配备了大面积硅漂移探测器，特别适用于在小工件上测量超薄镀层的厚度或者进行痕量分析。

XDV- $\mu$ 测量空间宽大，样品放置便捷，特别适合测量平面和大型板材类的样品，还特意面积为超大的板材类样品（例如大线路板）留有一个开口（C型槽）。连续测试或镀层厚度和元素分布的测量都可以方便地用快速可编程XY工作台完成。

为了使每次测量都能在最佳激励条件下进行，XDV- $\mu$ 系统特意配备了4个可切换的基本滤片。



引线框架: Au/Pd/Ni/CuFe

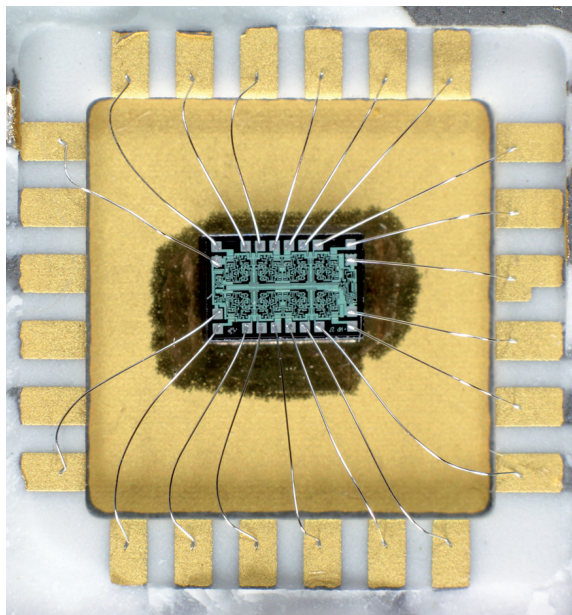


线材: Sn/Cu



操作很人性化，测量门带有大观察窗，并能大角度开启，仪器前部控制面板具备多种功能，日常使用轻松便捷。

带有三种放大倍率变焦的高像素视频系统能精确地定位样品，即使是非常细的线材或者是半导体微小的接点都能高质量地显示出测量点所在位置。激光点作为辅助定位装置进一步方便了样品的快速定位。



良好的性能和测量极小样品的专长使得XDV- $\mu$ 仪器成为研究开发、质量认证和实验室的理想选择，同时也是质量控制和产品监控必不可少的设备。

## 应用实例

PCB领域的一个典型镀层结构是Au/Pd/Ni/Cu/PCB 而且测量点的宽度通常都小于100  $\mu\text{m}$ ，Au层和Pd层的厚度都在10到100 nm之间。使用半宽高为20 $\mu\text{m}$ 的XDV- $\mu$ 进行测量，Au层和Pd层的重复精度分别可达到~0.1 nm和~0.5 nm。

### 特征

- 带有铍窗口和钨钼的微聚焦X射线管，可选钨管。最高工作条件：50kV，50W
- X射线探测器采用珀尔帖致冷的硅漂移探测器
- 多毛细孔X射线聚焦装置，测量点约20-40  $\mu\text{m}$  FWHM（半高宽）
- 4个可切换基本滤片
- 带弹出功能的可编程XY平台
- 视频摄像头可用来实时查看测量位置，十字线上有经过校准的刻度标尺，而测量点实际大小也在图像中显示。

### 典型应用领域

- 测量PCB、引线框架和晶片上的镀层系统
- 测量微小工件和线材上的镀层系统
- 分析微小工件的材料成分



SMD元器件：铅含量检测

晶片：Au/Pd/Ni/Cu/Si晶片